

2027年3月期 第1四半期（2026年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年7月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員・CFO ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2027年3月期 第1四半期 連結決算の概要

2026年7月30日

常務執行役員・CFO ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



損益状況（四半期）

（億円）

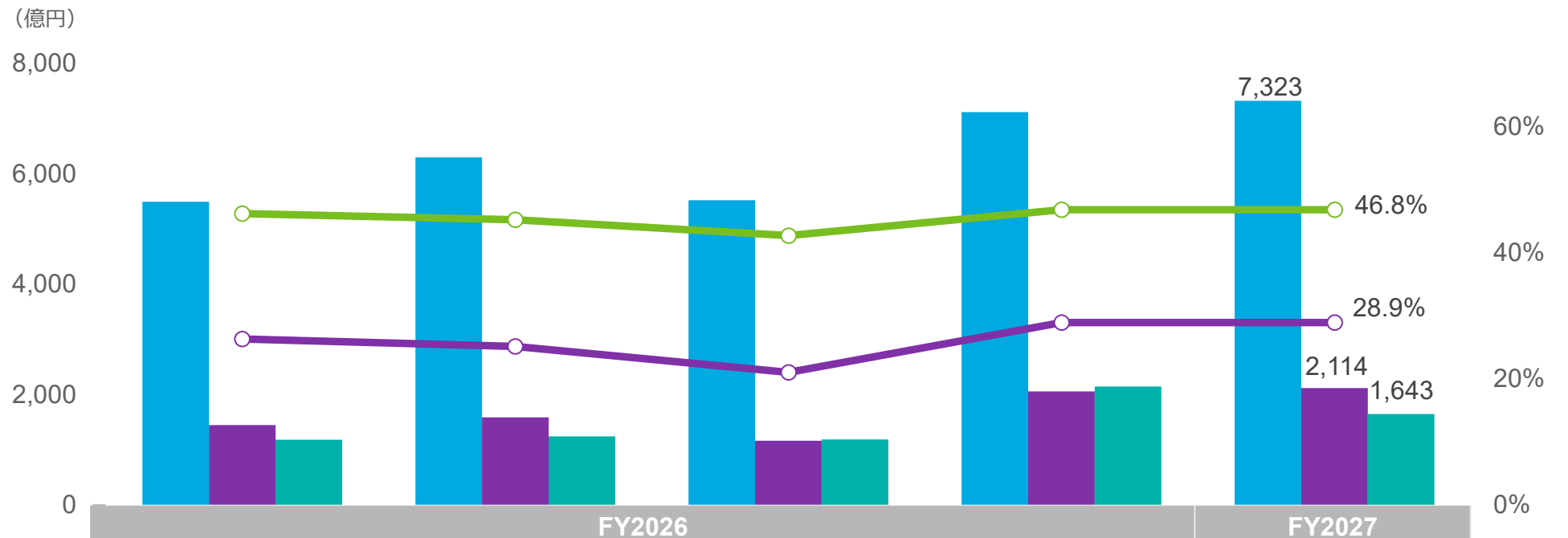
	FY2026				FY2027	vs. FY2026 Q4	vs. FY2026 Q1
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
売上高	5,495	6,300	5,520	7,118	7,323	+2.9%	+33.3%
売上総利益	2,539	2,848	2,358	3,331	3,427	+2.9%	+34.9%
売上総利益率	46.2%	45.2%	42.7%	46.8%	46.8%	±0.0pts	+0.6pts
販管費	1,092	1,264	1,196	1,275	1,313	+2.9%	+20.2%
営業利益	1,446	1,584	1,161	2,056	2,114	+2.8%	+46.1%
営業利益率	26.3%	25.1%	21.0%	28.9%	28.9%	±0.0pts	+2.6pts
税金等調整前当期純利益	1,519	1,610	1,533	2,818	2,154	-23.5%	+41.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,178	1,238	1,185	2,142	1,643	-23.3%	+39.5%
研究開発費	621	726	662	767	720	-6.2%	+15.9%
設備投資額	528	912	303	416	399	-4.1%	-24.4%
減価償却費	171	191	211	235	225	-4.4%	+31.2%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

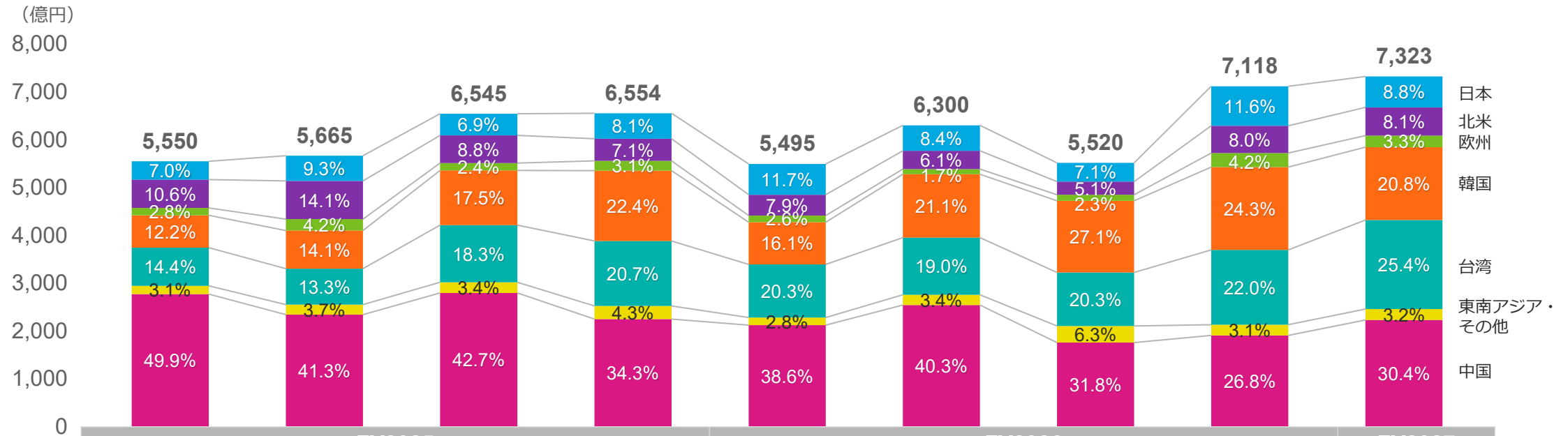
3. FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。FY2027は2026年4月～2027年3月の会計年度を指しています。

損益状況（四半期）



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	5,495	6,300	5,520	7,118	7,323
営業利益	1,446	1,584	1,161	2,056	2,114
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,178	1,238	1,185	2,142	1,643
売上総利益率	46.2%	45.2%	42.7%	46.8%	46.8%
営業利益率	26.3%	25.1%	21.0%	28.9%	28.9%

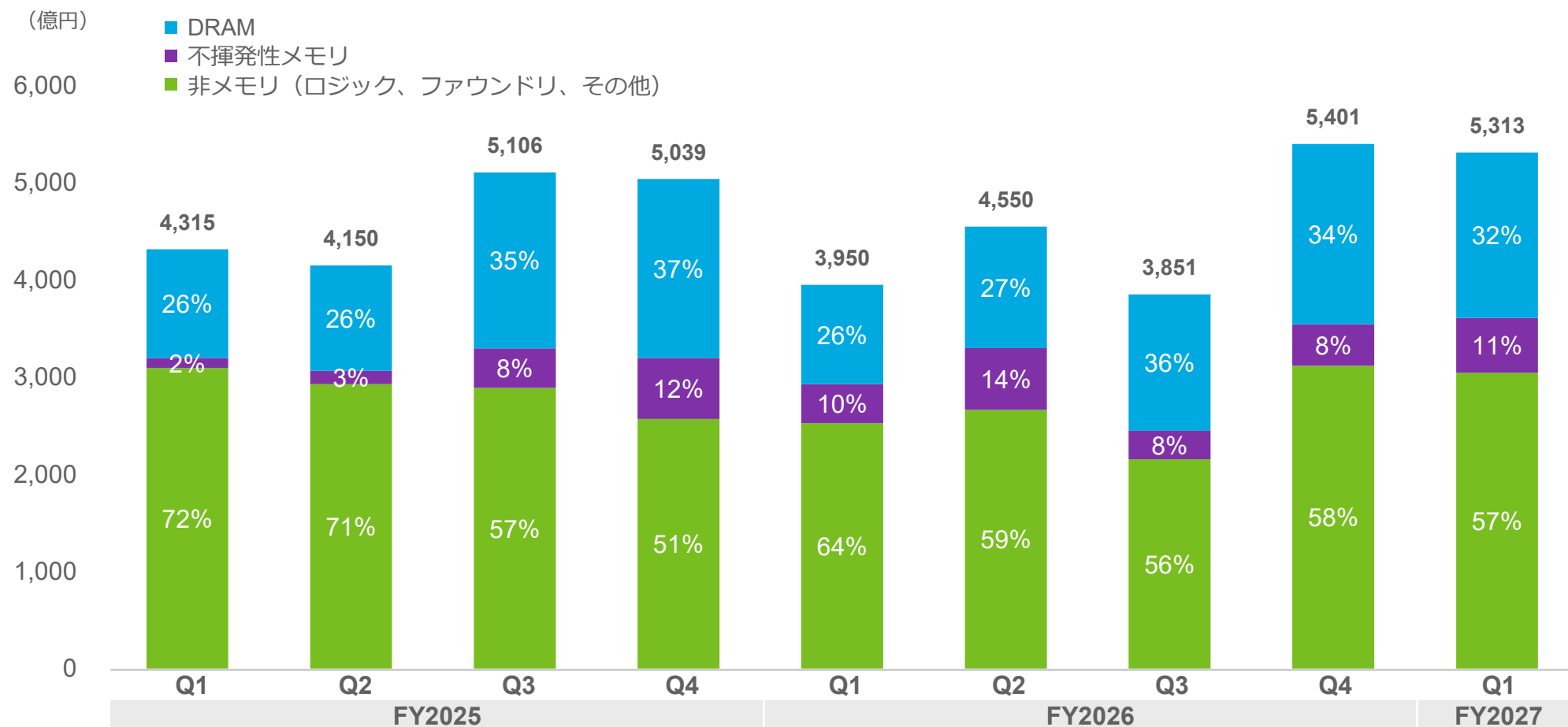
地域別売上高構成比（四半期）



	FY2025				FY2026				FY2027
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
日本	385	526	453	534	643	529	393	828	646
北米	590	799	577	462	434	384	278	567	590
欧州	155	238	157	203	140	108	127	297	242
韓国	678	795	1,145	1,470	883	1,325	1,497	1,731	1,524
台湾	800	753	1,193	1,358	1,115	1,197	1,119	1,565	1,861
東南アジア・その他	170	212	223	278	156	213	348	221	229
中国	2,770	2,339	2,794	2,246	2,121	2,541	1,755	1,907	2,229

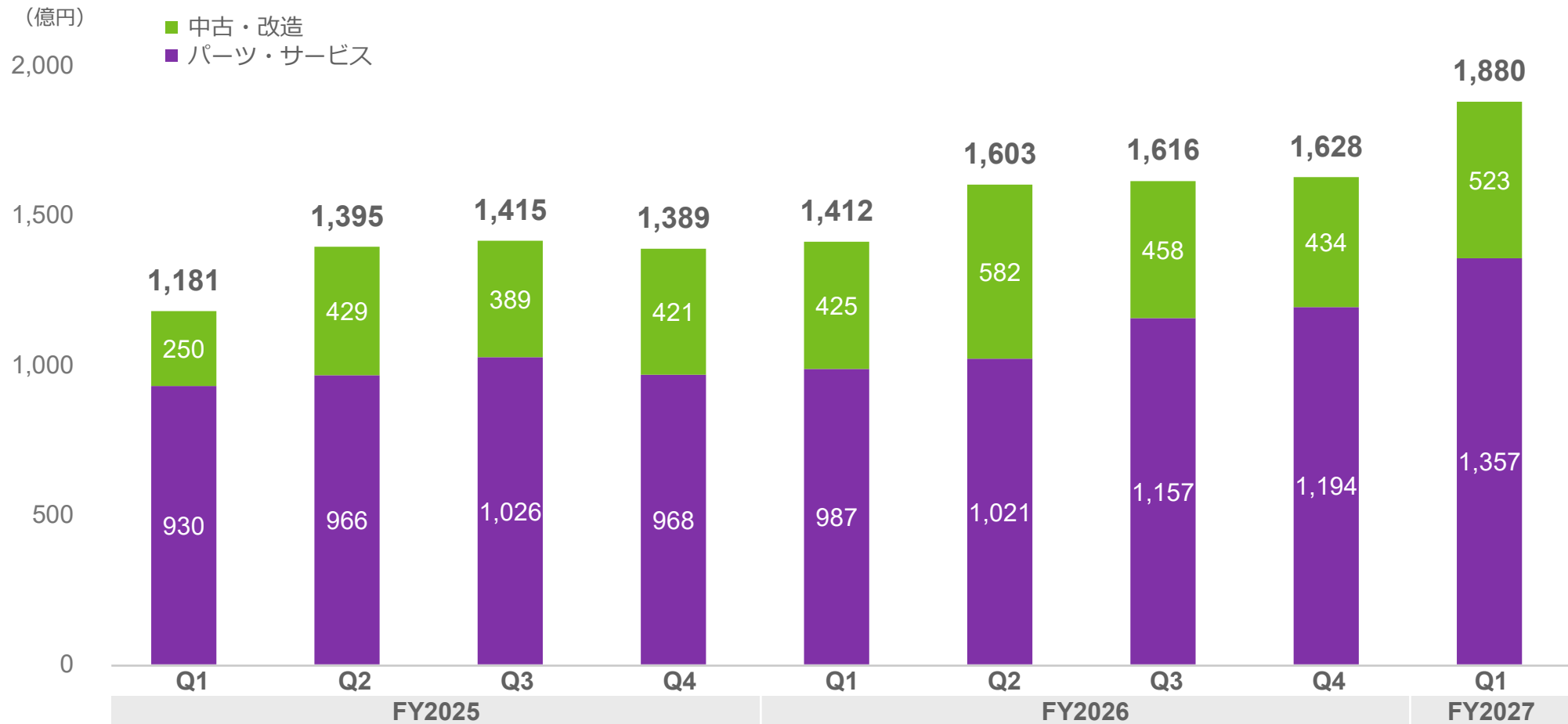
FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



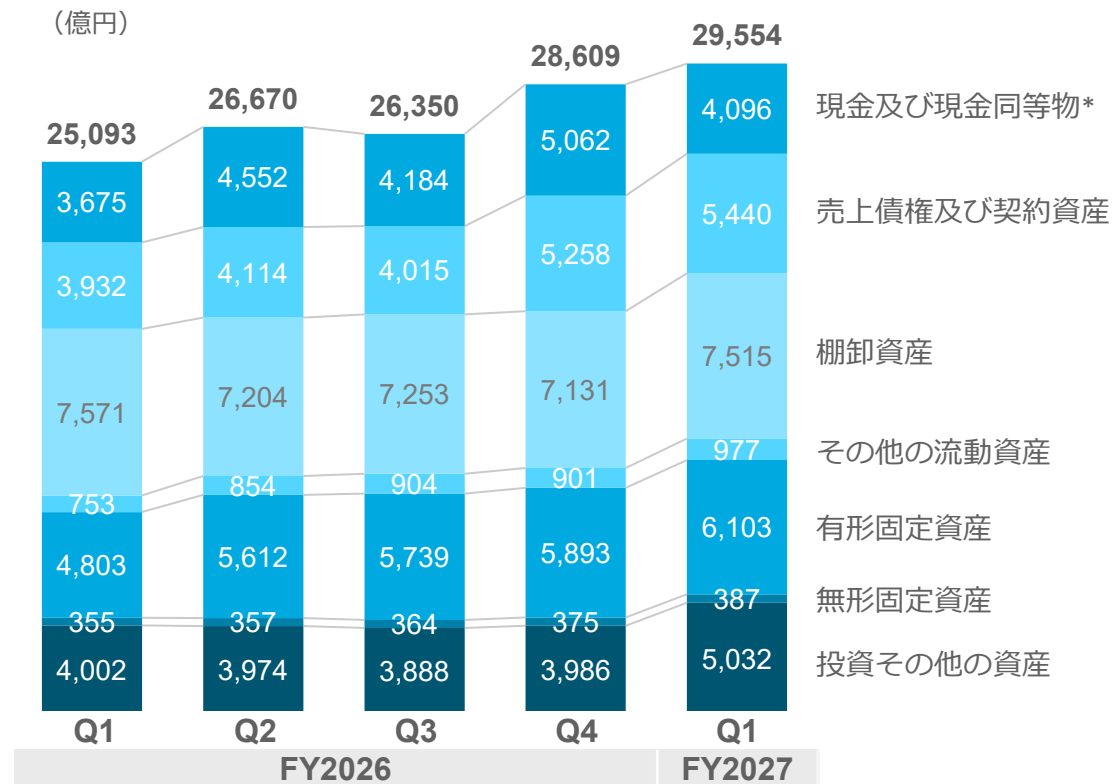
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

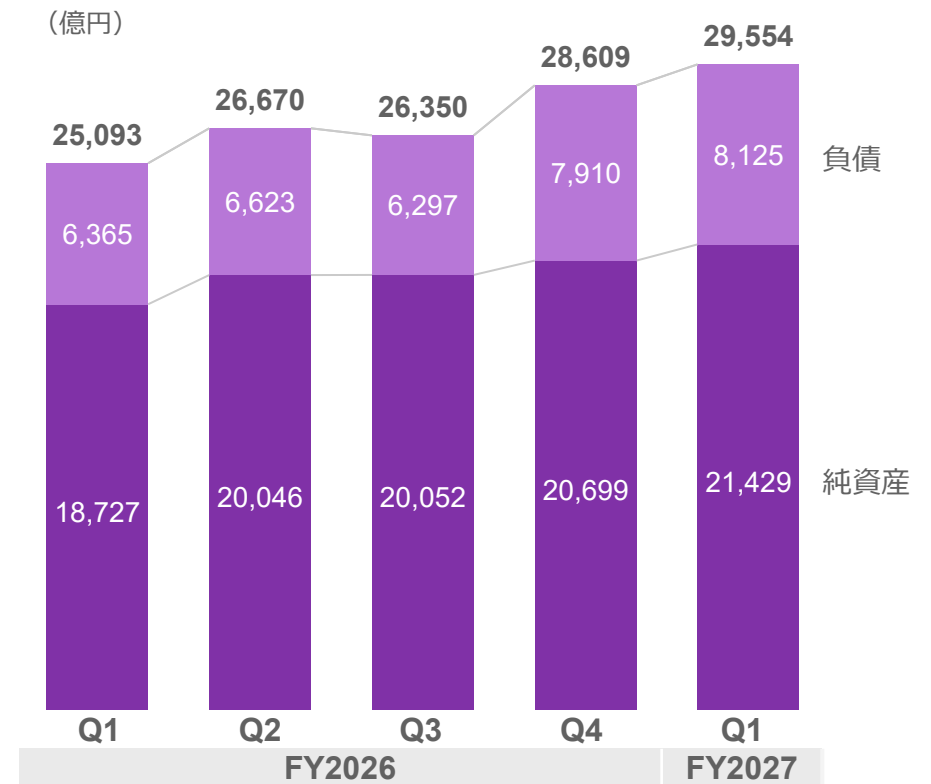


貸借対照表（四半期）

資産

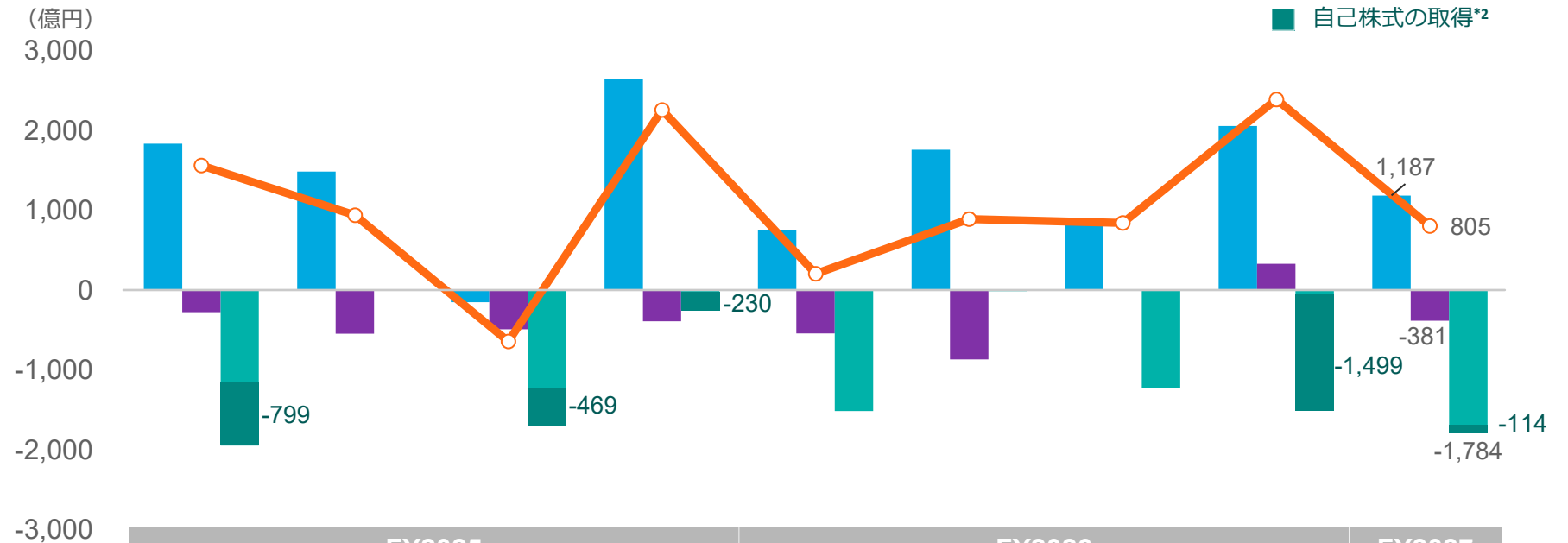


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2025				FY2026				FY2027
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 営業キャッシュ・フロー	1,837	1,486	-150	2,648	749	1,758	831	2,057	1,187
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-273	-544	-490	-389	-541	-867	12	332	-381
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,944	-6	-1,701	-235	-1,511	-10	-1,223	-1,508	-1,784
○ フリーキャッシュ・フロー*3	1,564	941	-641	2,258	207	891	843	2,390	805
手元資金残高*4	4,385	5,255	2,955	4,962	3,675	4,552	4,184	5,062	4,096

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です。

*3 フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*4 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

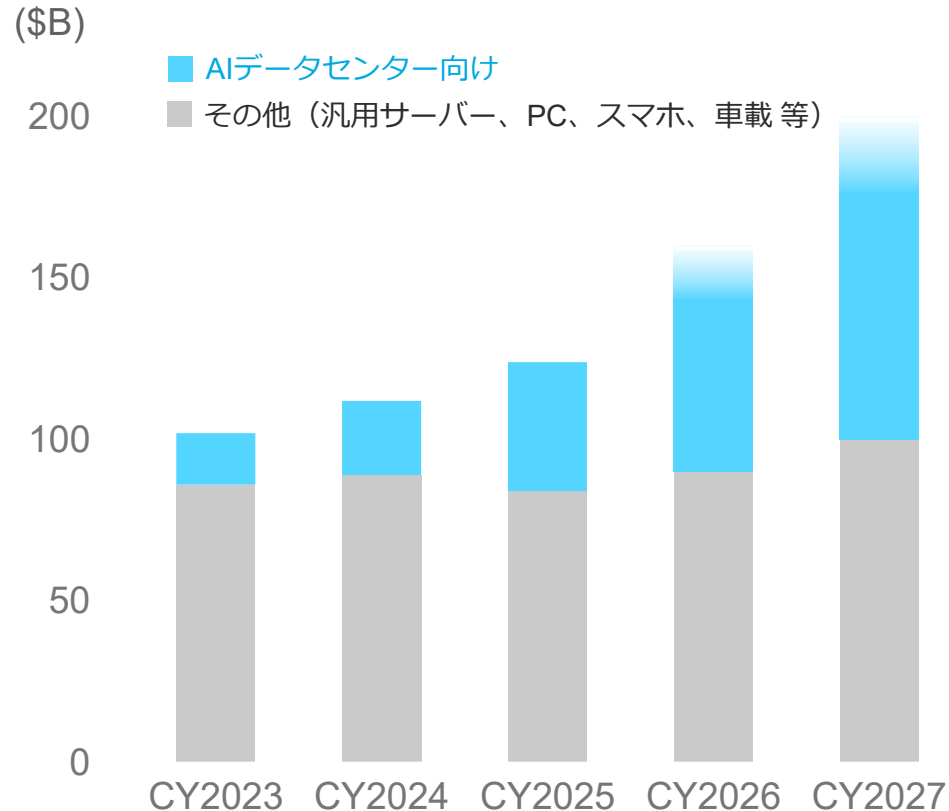
2026年7月30日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



事業環境（2026年7月時点でのWFE市場の見方）

WFE市場の推移

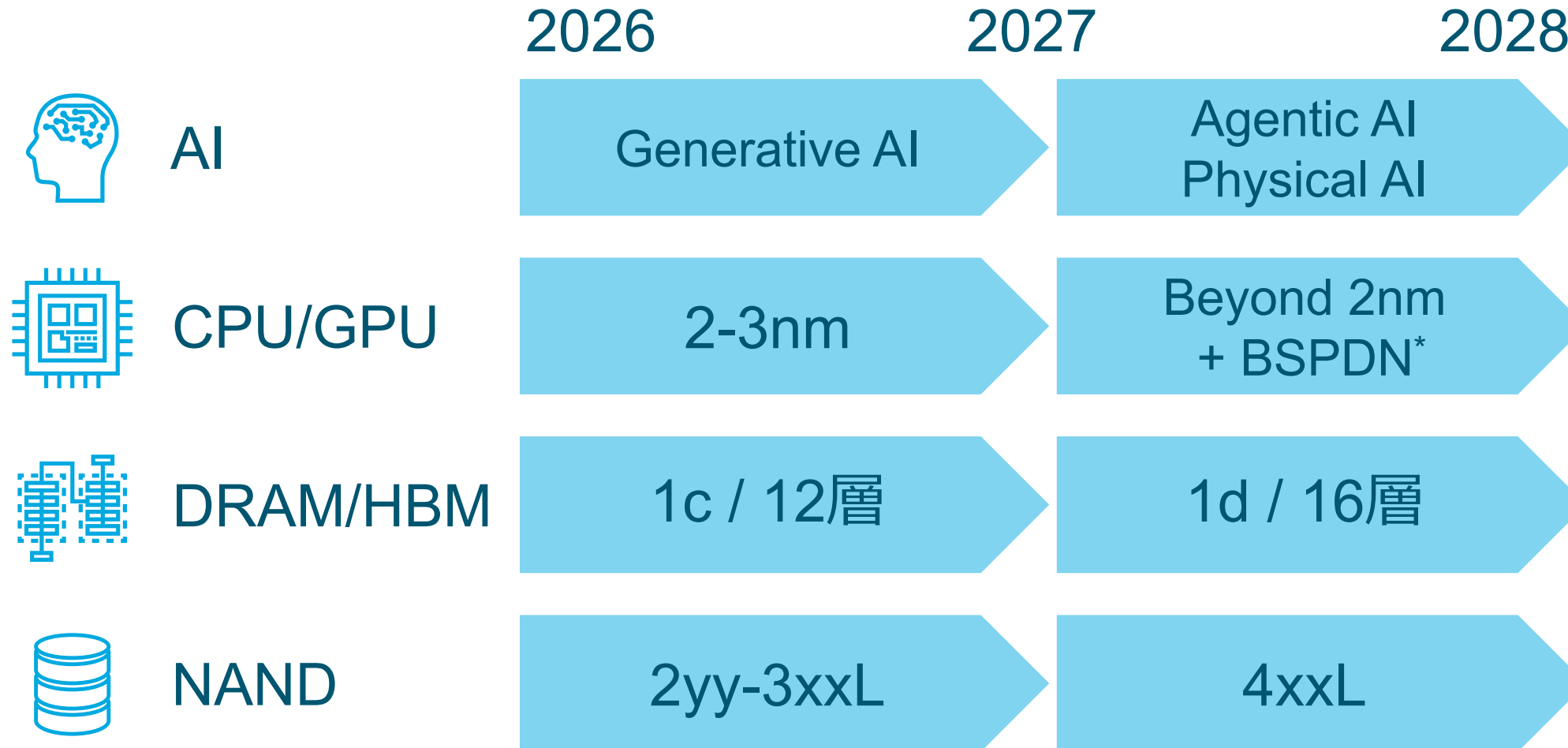


WFE市場の見通し

- CY2026：\$150B以上
- CY2027：\$190B以上
- GPU・HBMに加え、汎用メモリ・CPUの需要が拡大
- 先端デバイス向けの投資計画が加速

AIデータセンター向けが、WFE全体の50%に達する勢いで成長
先端領域に注力する当社の事業機会は一層拡大

AIの進化と半導体の技術トレンド



*BSPDN (Backside Power Delivery Network) : 電源供給配線をシリコンの裏面に配置する構造

AIの進化とともに、各デバイスで大きな技術革新が実現する

中期経営計画 財務目標達成に向けた進捗

財務目標（～2027年3月）		
売上高	≥ 3兆円	On Track
営業利益率	≥ 35%	In Progress
ROE	≥ 30%	On Track

営業利益率の目標達成はチャレンジングだが、
これまでの着実な進捗により、1兆円の営業利益が視野に

収益性改善に向けた取り組み

1. 付加価値の高い次世代装置の創出
2. 生産性向上に寄与するアップグレード
3. AIやロボティクスを利用したサービスの展開 + *Epsira*
4. スタートアップの効率化・短縮
5. 価格設定の適正化

稼ぐ力を究明・追求し、市場の変化に適切に対応する

2027年3月期の事業進捗と今後の事業機会

事業進捗

(FY2027売上成長ドライバー)

塗布現像	売上成長率 50%+ YoY	■ 新製品CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™ 順調に展開中 ■ 先端ロジック・DRAMの複数工程でPOR*1
------	-----------------------------	---

エッチング	売上成長率 25%+ YoY	■ 先端ロジック/メモリの投資加速で通期売上1兆円が視野に ■ DRAM向けHARCエッチングで新モデルでの評価が順調に進捗
-------	-----------------------------	---

Advanced Packaging	売上成長率 70%+ YoY	■ 特にプローバは、ハイエンドロジックで圧倒的なポジション。通期1,000億円を大きく超える見通し。新モデルの評価も順調
--------------------	-----------------------------	---

今後の事業機会

(ハイライト)

POR→ 量産展開へ	■ 極低温エッチング ■ 新低抵抗メタル成膜 ■ ハイブリッドボンディング
---------------	---

累積売上 ～2030年	■ DRAM配線工程エッチング装置 : 1兆円 ■ ボンディング関連装置 : 5,000億円
----------------	---

新規参入 SAM拡大	■ 埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD : PECVD市場の約10% ■ デバイスプローバ : プローバ市場の 約10～15% Prexa™ SDP*2をリリース
---------------	---

*1 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 SDP : Singulated Device Prober

2027年3月期上期 業績予想

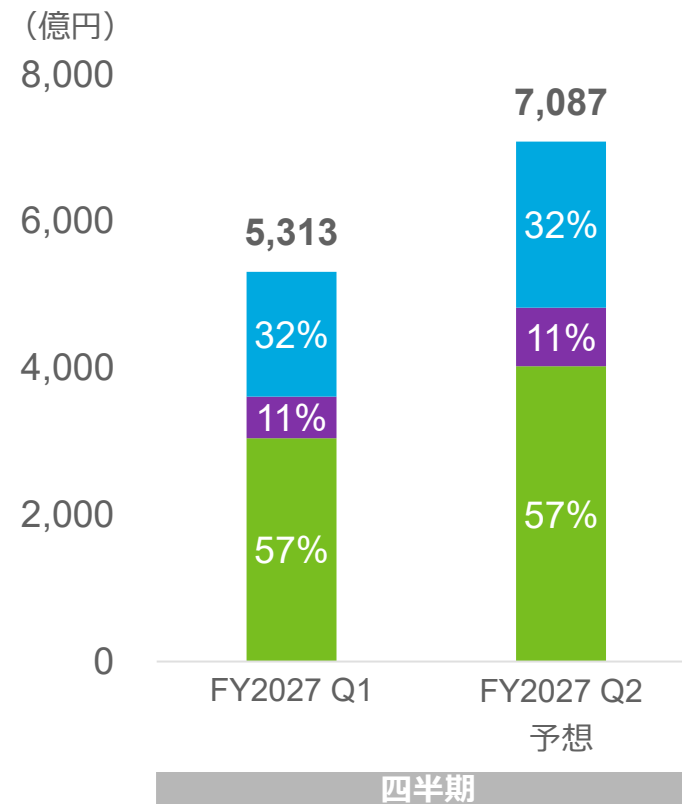
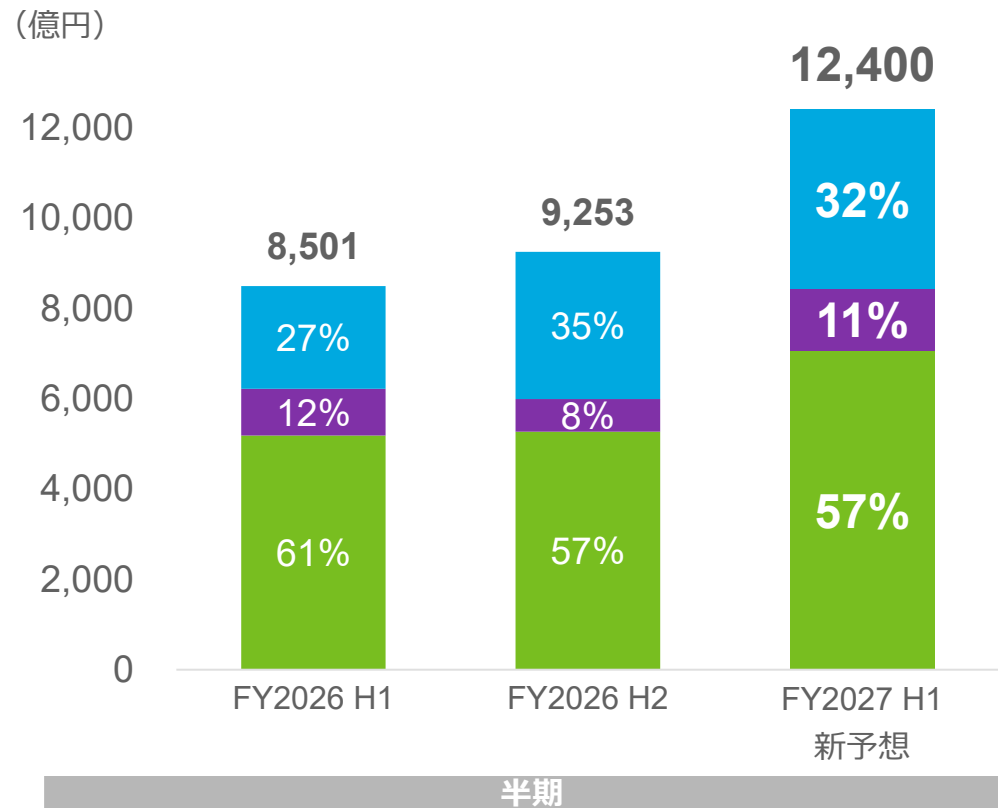
	FY2026 (実績)			FY2027 (新予想)	(億円)
	H1	H2	通期	H1	FY2027 4/30時点 (予想)
売上高	11,796	12,638	24,435	16,200	15,700
売上総利益 売上総利益率	5,388 45.7%	5,690 45.0%	11,078 45.3%	7,480 46.2%	7,150 45.5%
販管費	2,357	2,472	4,829	2,900	2,840
研究開発費	1,348	1,430	2,778	1,600	1,600
研究開発費以外の販管費	1,008	1,041	2,050	1,300	1,240
営業利益 営業利益率	3,031 25.7%	3,217 25.5%	6,249 25.6%	4,580 28.3%	4,310 27.5%
税金等調整前 当期純利益	3,129	4,351	7,481	4,640	4,370
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,416	3,328	5,744	3,490	3,280
1株当たり当期純利益（円）	527.31		1,254.57	767.51	721.12

- FY2027 上期：
活況な先端投資を背景に、
売上高を1兆6,200億円へ上方修正
- FY2027下期：
需要拡大の勢いは一段と加速。
上期を大きく上回る成長を想定
 - － 中東情勢の影響、サプライチェーンの動向は要注視

2027年3月期上期 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比

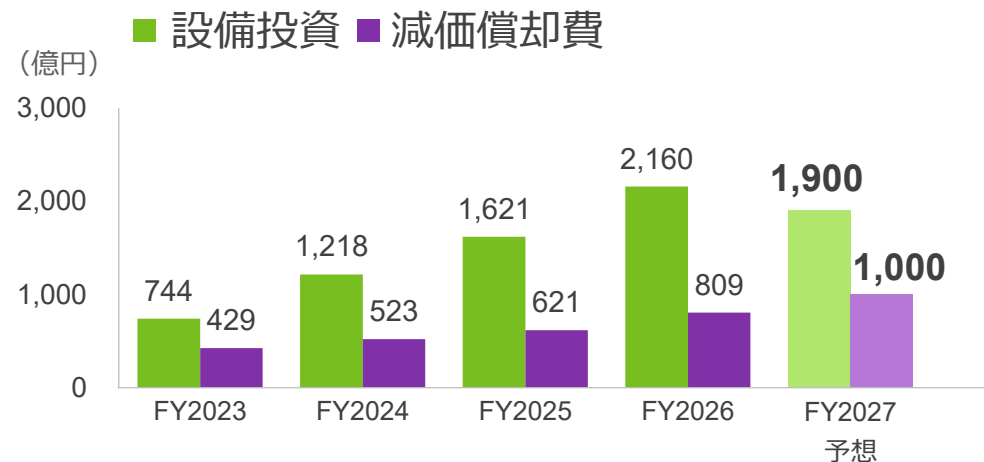
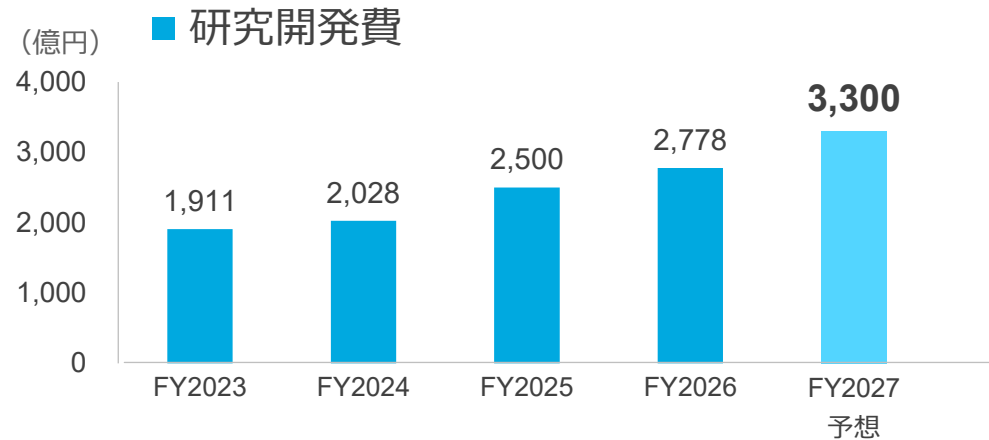
■ DRAM ■ 不揮発性メモリ ■ 非メモリ(ロジック、ファウンドリ、その他)



* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

上期の新規装置売上を1兆2,400億円に上方修正
Q2は四半期最高の7,087億円（前四半期比 +33%）を見込む

2027年3月期 研究開発費・設備投資計画



宮城県黒川郡
2027年夏竣工予定

スマートプロダクション構想の目標

労働生産性

4倍

スペース効率

3倍

生産リードタイム

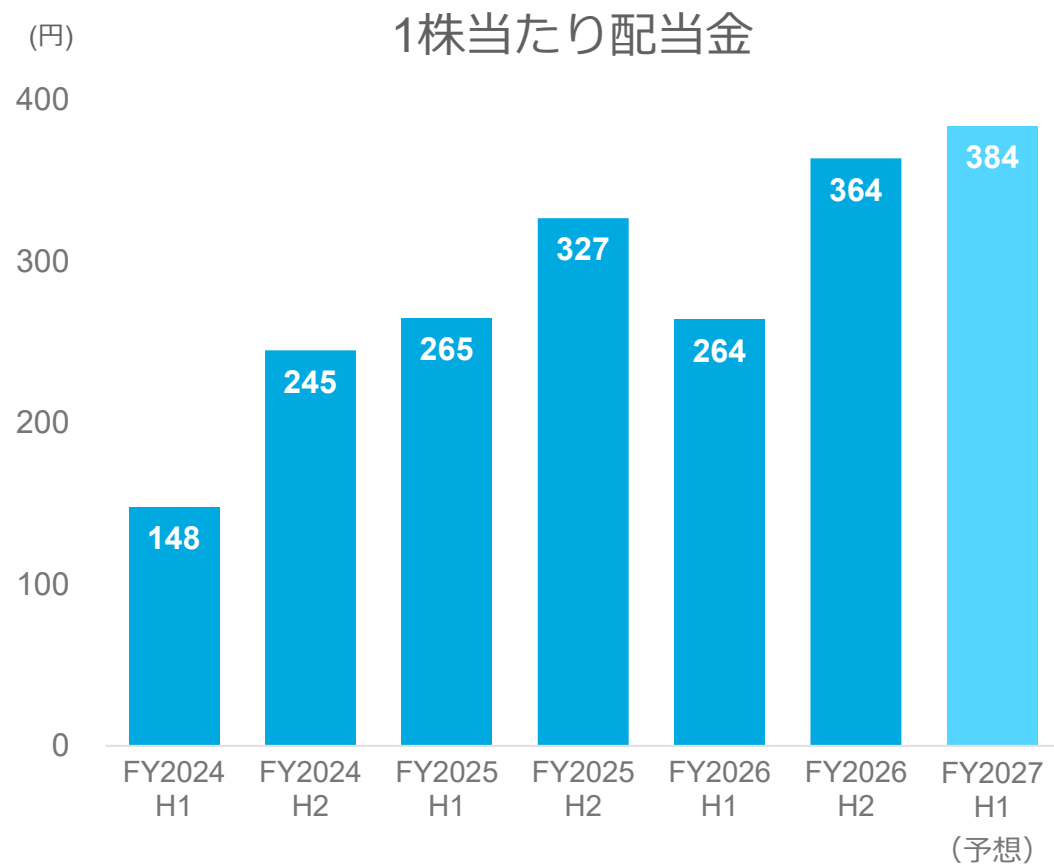
1/3

生産キャパシティ

3倍

研究開発投資を主軸に競争力の強化を継続
強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉える

配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金50円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

FY2027 H1（中間配当）の1株当たり配当金は384円に上方修正

自己株式の取得

最大1,500億円の自己株式取得を実行中

- 2026年5月29日開催の取締役会での決議内容
 - － 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
 - － 取得し得る株式の総数 : 750万株（上限）*
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.6%)
 - － 株式の取得価額の総額 : 1,500億円（上限）*
 - － 取得する期間 : 2026年6月1日～2027年3月31日

* 市場環境等により、全部の取得がおこなわれない可能性があります。

- 2026年6月30日現在の取得状況
 - － 取得した株式の総数 : 207,100 株
 - － 株式の取得価額の総額 : 11,474,246,000 円

拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、
今後も適切なバランスシート・マネジメントを実施

株式分割

-
- | | |
|------|--|
| ■ 目的 | 投資単位当たりの金額を引き下げることにより、
より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る |
|------|--|
-
- | | |
|---------|--|
| ■ 分割の方法 | 2026年9月30日を基準日として、同日付の株主の所有する
当社普通株式を1株につき5株の割合をもって分割 |
|---------|--|
-
- | | |
|------|--|
| ■ 日程 | 基準日公告日 2026年9月15日(火)
基準日 2026年9月30日(水)
効力発生日 2026年10月1日(木) |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| ■ 配当 | 2026年9月30日を基準日とする2027年3月期の間配当は、
株式分割前の株式数を基準に実施 |
|------|--|
-

新体制のご紹介

■ コーポレートオフィサー

河合 利樹^{*1}

CEO（最高経営責任者）

林 伸一^{*1 *2}

開発生産担当

多田 新吾^{*2}

顧客戦略担当、Global Customer Engineering担当

堂 和寛^{*2}

コーポレート戦略企画担当

石田 博之^{*1}

COO（最高執行責任者）

秋山 啓一

製品事業担当

阿曾 達也^{*2}

Global Business Platform担当

^{*1} 取締役を兼務

^{*2} 新任

■ 新体制におけるCxO（抜粋）



CEO 河合 利樹



COO 石田 博之



CFO 川本 弘



TOKYO ELECTRON

本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。